

公開番号 又は 特許番号	特開 2014-178293
発明名称	マイクロプローブおよびマイクロプローブの製造方法
出願人 又は 権利者	株式会社東芝、国立大学法人東京大学
想定デバイス	アンビエントデバイス、その他
要約	<p>【利用分野】 プローブ先端の電氣的な接触スポットの広がり抑制することで電氣的特性の長期安定化を実現する。</p> <p>【発明の内容】 実施形態に係るマイクロプローブは、表面に第1電極を有する土台と、前記土台により支持され、第2電極および第3電極を有するレバーと、を具備する。前記第2電極は、前記第1電極と前記第3電極との間に接続される。前記第3電極は、前記第2電極から前記レバーの主面内の第1方向に突出するように形成される。前記主面内で前記第1方向に直交する第2方向における前記第3電極の幅は、前記主面に直交する第3方向に前記第3電極を用いて走査を行う際の電氣的接触領域の幅を規定する。</p>
図面	<p>図1</p>